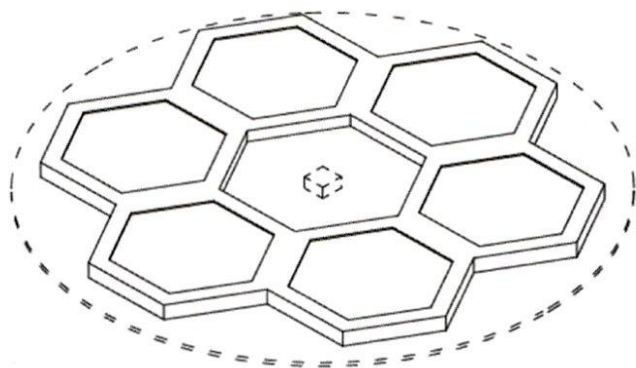
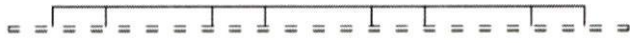


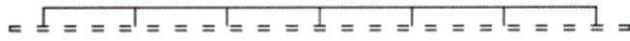
- (19) 【発行国】日本国特許庁 (JP)
- (45) 【発行日】令和6年10月2日 (2024. 10. 2)
- (12) 【公報種別】意匠公報 (S)
- (11) 【登録番号】意匠登録第1781270号 (D1781270)
- (24) 【登録日】令和6年9月24日 (2024. 9. 24)
- (54) 【意匠に係る物品】センサモジュール
- (52) 【意匠分類】H1-5500
- (51) 【国際意匠分類】Loc (14) C1. 10-05
【Dターム】H1-5500VZA
- (21) 【出願番号】意願2024-11776 (D2024-11776)
- (22) 【出願日】令和6年6月11日 (2024. 6. 11)
- (31) 【優先権主張番号】112306924
- (32) 【優先日】令和5年12月30日 (2023. 12. 30)
- (33) 【優先権主張国・地域又は機関】台湾 (TW)
- (72) 【創作者】
【氏名】林駿杰
【住所又は居所】台湾新竹科學▲園▼區新竹市力行五路1號
- (73) 【意匠権者】
【識別番号】523433790
【氏名又は名称】台亞半導體股▲フン▼有限公司
【氏名又は名称原語表記】Taiwan-Asia Semiconductor Corporation
n
【住所又は居所】台湾新竹科學▲園▼區新竹市力行五路1號
【住所又は居所原語表記】No. 1, Li-Hsin 5th Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan
- (74) 【代理人】
【識別番号】100167689
【弁理士】
【氏名又は名称】松本 征二
【審査官】成田 陽一
- (55) 【意匠に係る物品の説明】この物品は、ウェアラブルデバイス上で使用され、光を受光し電流信号または電圧信号に変換するために複数の六角形のフォトダイオードをリング状に配置したセンサモジュールである。
- (55) 【意匠の説明】実線で表わした部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図は、正面図と対称に表れるため省略する。右側面図は、左側面図と対称に表れるため省略する。
- 【図面】
【斜視図】



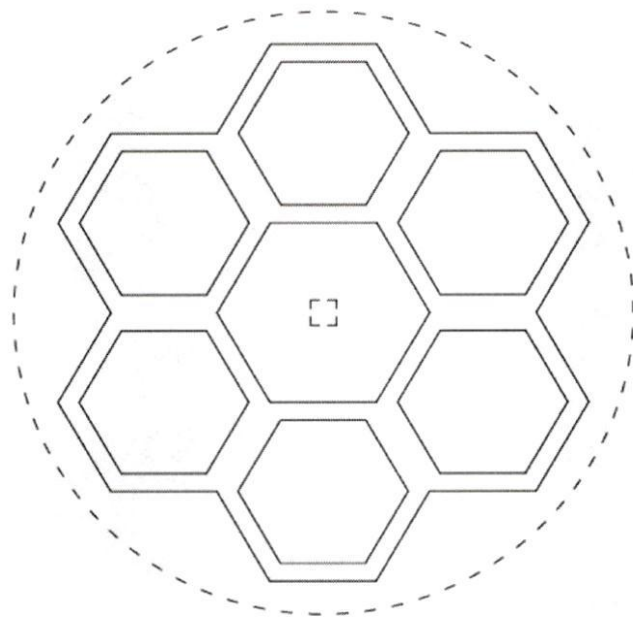
【正面図】



【左側面図】



【平面図】



【底面図】

